



# 2018 海峽兩岸暨亞太先進基板研磨加工技術研討會

## Cross Strait and Asia-Pacific Conference on Wafer Planarization/CMP Technology (APWCMP) 2018 & Taiwan-Japan-Korea Joint Symposium for Wafer Planarization Technology (TJK-WPT) 2018

時間：2018年05月29日～06月03日

地點：高雄蓮潭國際會館（高雄市左營區崇德路801號）

### 主辦單位：

- 社團法人臺灣平坦化應用技術協會
- 晶圓平坦化創新研究中心
- 臺灣科技大學
- 臺灣財團法人金屬工業研究發展中心

### 協辦單位

- 中國平坦化技術聯盟
- 中國摩擦學會微納製造摩擦學專業委員會

### 活動目標

促進兩岸晶圓基板加工技術信息交流，俾使高階半導體和光電晶圓基板相關產業更加蓬勃，更精準掌握關鍵產品切入之商機。

### 活動起源、構想

臺灣半導體產業之製造能力，主導全球，而中國亦視為重點工業，迅速擴展，其潛能不絕可忽視。臺灣平坦化技術應用協會，在2012年9月首次舉辦海峽兩岸先進基板研磨加工技術交流，會後，兩岸在此領域關鍵人物決定此活動當成為常規活動，每年進行，地點輪替。歷經2013年5月在河北工業大學、2014年5月在勤益科技大學、2015年5月在北京清華大學舉行，2016年5月在臺灣科技大學舉辦及2017年5月23日在大連理工大學舉辦，今年則將在5月29日至6月3日於臺灣高雄蓮潭會館舉行。本次論壇除了延續先前雙方交流的架構外，也將邀請亞太區域的化學機械平坦化/拋光(CMP)產學專家共襄盛舉，藉專題演講之學術交流，探究兩岸以至亞太地區在基板研磨領域之現況、趨勢，交換化學機械研磨/平坦化相關先進資訊與經驗，促進此工藝的進步與創新，也使本土之相關產業，更能有效的運用資源，開發研磨加工先進技術，拓展產業之商機，並對半導體產業發展有直接的助益。此外，海峽兩岸間的科技交流互動，近來漸已成為國際間注目的焦點，世界各國對中國在IC產業的發展方向與策略規劃，也都頗為關注，此次研討會也將針對此一議題，進行深入探討與交流，期盼本次的研討會能讓與會人士在技術提升及企業發展規劃方面都能有所助益。



## 研討會主題：Advanced CMP Process for Hybrid-IC Device

### 論文主題：

- Si 晶圓加工技術
- Sapphire/Sic 晶圓加工技術
- ILD/STI CMP
- 先進 CMP 材料與工藝技術
- Cu/低介電材料 CMP
- CMP 設備及關鍵零組件
- CMP 製程整合與控制
- CMP 量測技術
- CMP 後清洗與缺陷
- CMP 耗材與檢驗
- CMP 理論、建模與模擬
- CMP 新興技術
- 3D ICs/TSV 應用
- 綠色 CMP
- CMP 之 Non-Si IC 應用(LED, PCB, 顯示器, 資料儲存設備等)
- CMP & IC 產業發展及行銷策略規劃

### 特約講員及邀請講員：

先進學研單位：臺灣清華大學、臺灣勤益科技大學、台灣金屬工業研究發展中心、中國科學院上海微系統研究所、北京清華大學、復旦大學、大連理工大學、河北工業大學及日本九州大學、韓國釜山大學之學者。

平坦化製程設備和主要供應商：台積電、Pall Filter (Beijing) Co., Ltd. 等相關領域之學者專家。

### 研討會時間及方式：

05 月 30 日：以中文進行會議

05 月 31 日：以英文進行會議

06 月 01 日~06 月 03 日：企業參訪與學術交流

### 重要日期：

- 投稿開始日: 2月15日
- 第二次摘要初稿收件截止日: 4月25日
- 第二次摘要初稿接收通知日: 4月30日
- 第二次完整摘要收件截止日: 5月4日

### 廠商廣告／贊助

贊助大會及刊登廣告，可介紹您的公司及產品，並將有機會認識相關廠商及客戶之決策者，相互交流資訊，敬請把握機會，及早登記（「廠商廣告及贊助辦法」請見研討會網站）。

## 論文投稿

### 重要日期:

- 投稿開始日: 2月15日
- 第二次摘要初稿收件截止日: 4月25日
- 第二次摘要初稿接收通知日: 4月30日
- 第二次完整摘要收件截止日: 5月4日

\*\* 詳細投稿、海報及註冊資訊將於近期公告，請密切注意本協會網站  
(<http://www.cmpug.org.tw/news.php>) 及

研討會網站(<http://www.cmpugtw.url.tw>)之最新資訊!

\*\*請注意!!\*\*

本次研討會僅安排「特約講員」及「邀請講員」演講，所有被接受之論文摘要均以張貼海報形式呈現，並將論文摘要收印於大會論文集中心。

摘要獲接受之投稿作者需註冊參加研討會，並於5月10日前完成繳費，摘要才會被收錄論集中!

### • 論文投稿

1. 請將投稿資料表及論文摘要以 email 方式寄至: [apwcmp2018@gmail.com](mailto:apwcmp2018@gmail.com)
2. 投稿郵件之主旨請填寫: APWCMP2018\_論文題目
3. 獲得接受後，摘要將會收印於研討會論集中。摘要請以中文或英文撰寫，投稿資料表與摘要中英文格式請參考以下超連結範本檔。

### • 投稿資料表:

投稿資料表 (下載網址: <http://t.cn/REQpVgZ>)

### • 摘要格式範本:

摘要中文範本 (下載網址: <http://t.cn/REQp5zf>)

摘要英文範本 (下載網址: <http://t.cn/REQpUTw>)

### • 海報

#### 海報尺寸 (A0 size, about 85 x 120 cm, 1頁)

摘要獲得接受後，請製作一份海報，攜帶至會場，張貼於研討會海報區，並請於Poster Session時做解說。

### • 論文投稿聯絡人及電郵:

丘群 (Chun Chiu) [cchiu@mail.ntust.edu.tw](mailto:cchiu@mail.ntust.edu.tw) 及

趙家瑜 (Doris Zhao) [chiayu@mail.ntust.edu.tw](mailto:chiayu@mail.ntust.edu.tw)

Tel: 886-2-2730-3296 Fax: 886-2-2737-6460

# 研討會議程 (1)

| Date        | May 29  | May 30   | May 31   | June 1   |                           |
|-------------|---|--|--|--|---------------------------|
| Time/Venue  | Garden Villa, Kaohsiung City, Taiwan  |  |  |  |                           |
| 08:30~09:30 |   | Cross-strait CMP 2018  | APWCMP2018 & TJK-WPT2018   |  |                           |
| 09:30~10:30 | 研習會<br><br>講者<br>康來成博士/<br>創恆有限公司<br>資深顧問<br>、<br>吳國俊博士/<br>電子基板事業群<br>暨創新科技中心<br>總經理<br>、<br>林志明博士/<br>台灣荏原精密股<br>份有限公司<br>(Ebara) 經理<br>、<br>路新春博士/<br>華海清科機電<br>科技有限公司 | Registration<br><br>Opening Remarks (海峽兩岸)<br>09:30~09:50<br>林秋豐 博士<br>金屬工業研究發展中心執行長<br>路新春 教授<br>中國北京清華大學機械工程系摩擦<br>學國家重點實驗室長江學者<br>陳炤彰 教授<br>台灣平坦化應用技術協會理事<br>長/臺灣科技大學機械系主任<br><br>主持人：TPD | Registration<br><br>Opening Remarks (亞太)<br>09:30~09:40<br>TPD<br>Session Chair：TPD<br>Keynote speech (K-3)<br>09:40~10:10<br>Prof. Haedo Jeong/School<br>of Mechanical<br>Engineering, Pusan<br>National University,<br>Korea<br><br>Invited speech (I-9)<br>10:10~10:30<br>Prof. Xin-Ping Qu/<br>School of<br>Microelectronics, Vice<br>Dean, School of<br>Information Science and<br>Technology, Fudan<br>University, China | Assemble & start off   |                           |
| 10:30~10:50 |   | Morning Break & Exhibition<br>主持人：TPD  | Keynote speech 中文(K-1)<br>10:00~10:30<br>劉玉嶺 教授/<br>河北工業大學微電子所   | Keynote speech (K-4)<br>10:50~11:20<br>Prof. Suzuki Keisuke,<br>Department of<br>Mechanical Information<br>Science and Technology,<br>Kyutech, Japan | Technical<br>Tour/<br>TBD |
| 10:50~12:00 |   | Invited speech 中文(I-1)<br>11:20~11:40<br>陳韋仁/<br>金屬工業研究發展中心  | Invited speech (I-10)<br>11:20~11:40<br>Prof. Pei-Lum Tso,<br>Department of Power<br>Mechanical Engineering,<br>National Tsing Hua<br>University, Taiwan   |  |                           |
|             |   | Invited speech 中文(I-2)<br>11:40~12:00<br>許為傑/ACM Research<br>(Shanghai), Inc 盛美半導體設備<br>(上海)有限公司   | Invited speech (I-11)<br>11:40~12:00<br>Dr. David Huang/Pall<br>Filter (Beijing) Co., Ltd.   |  |                           |

## 研討會議程 (2)

| Date        | May 29  | May 30  | May 31   | June 1 |
|-------------|---|---|--|--------|
| Time/Venue  | Garden Villa, Kaohsiung City, Taiwan  |   |  |        |
| 12:00~13:30 |   | Lunch Break   |  |        |
| 13:30~14:40 | 研習會<br>講者<br>康來成博士/<br>創恆有限公司<br>資深顧問<br>、<br>吳國俊博士/<br>電子基板事業<br>群暨創新科技<br>中心<br>總經理<br>、<br>林志明博士/<br>台灣荏原精密<br>股份有限公司<br>(Ebara) 經理<br>、<br>路新春博士/<br>華海清科機電<br>科技有限公司 | 主持人：TPD   | Session Chair：TPD  |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-3)<br>13:30~13:50<br>余安棣博士/<br>TSMC台灣積體電路製造股份<br>有限公司 | Opening Remarks (TJK-<br>WPT)<br>13:30~13:40<br>Prof. Chao-Chang Chen<br>(NTUST)                 |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-4)<br>13:50~14:10<br>蔡明義教授/<br>勤益科技大學機械工程系            | Taiwan-Japan-Korea Joint<br>Symposium<br>For Wafer Planarization<br>Technology<br>(TJK-WPT 2018) |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-5)<br>14:10~14:30<br>周瑞麟/<br>中國砂輪企業股份有限公司             | Section 1<br>13:40~14:40   |        |
| 14:40~15:10 |   | Afternoon Break & Exhibition  |  |        |
| 15:10~16:10 |   | 主持人：TPD   | Session Chair：TPD  |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-6)<br>15:10~15:30<br>劉衛麗教授/<br>中科院上海微系統與信息技術<br>研究所   | Taiwan-Japan-Korea Joint<br>Symposium<br>For Wafer Planarization<br>Technology<br>(TJK-WPT 2018) |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-7)<br>15:30~15:50<br>趙德文研究員/<br>中國北京清華大學機械工程系         | Section 2<br>15:10~16:10   |        |
|             |   | Invited speech 中文(I-8)<br>15:50~16:10<br>張振宇教授/<br>大連理工大學機械學院現代所          |  |        |
| 16:10~17:10 | Registration  | Poster Session 1<br>(Cross Strait CMP)                                    | Poster Session 2<br>(APWCMP)   |        |
| 18:30~20:30 | Welcome<br>Reception  | Committee and Speaker Meeting<br>(w/Dinner)                               | Conference<br>Banquet<br>(TSMC 陳其賢處長致詞)  |        |

※主辦單位保有隨時修改活動之權利，  
如有任何變更內容或詳細注意事項恕不另行通知。

## 研討會/研習會費用（僅適用於台灣及大陸參會者）：

| 註冊類型                      |       | 5月2日前報名<br>(新台幣)* | 5月2日後報名<br>(新台幣)* | 現場繳費<br>(新台幣)* | 備註                   |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 研習會<br>(5/29)             | 一般人士  | 4500 NTD          | 5000 NTD          | 6000 NTD       |                      |
|                           | 學生 ** |                   |                   |                |                      |
| 研討會<br>參加三天<br>(5/30-6/1) | 一般人士  | 12500 NTD         | 13500 NTD         | 15000 NTD      | 含晚宴及<br>企業參訪         |
|                           | 學生 ** | 6250 NTD          | 6750 NTD          | 7500 NTD       |                      |
| 研討會<br>全程參與<br>(5/30-6/3) | 一般人士  | 21000 NTD         | 22000 NTD         | 23000 NTD      | 含晚宴及<br>企業參訪<br>學術交流 |
|                           | 學生 ** | 14500 NTD         | 15000 NTD         | 15500 NTD      |                      |

註1：「台灣平坦化應用技術協會」會員打八折優惠。  
 註2：註冊費用包含一位參會者及一份研討會論文集，若需另加購論文集，每冊台幣1000元（人民幣220元），可於報到櫃台購買。

\* 本收費以台幣為基準。

\*\* 學生請攜帶學生證於會場報到時查驗。

\*\*\* 報名參加學術交流會另外提供行程表。

\*\*\*\* 5/29 舉辦海峽兩岸CMP研習會,課程內容會陸續提供!

※ 論文摘要獲接受之投稿作者需註冊參加研討會，並於5月10日前完成繳費，摘要才會被收錄論集中。

### 報名方式：

1. 線上報名並刷卡付費。
2. 銀行匯款（仍須先線上報名，然後至銀行匯款）

| 匯款資訊 (Remittance/Wire Transfer) Payment Method |   |
|--|---|
| 匯款銀行 (Bank)                                    | 合作金庫銀行三興分行 (代號：006)<br>Taiwan Cooperative Bank International Department |
| SWIFT  | TACBTWTP  |
| 戶名 (Beneficiary)                               | 台灣平坦化應用技術協會<br>Chemical Mechanical Planarization User Group Taiwan      |
| 帳戶 (Account No)                                | 1405717328730   |

3. 2018年03月01日開始線上報名及繳費，5月15日報名及繳費截止，逾期僅接受現場報名。

### 取消報名規定

若註冊組於以下時間收到要求取消報名之書面函（含email）：

1. 於5月20日前（含）收到，註冊費扣除20%手續費後，餘額退還註冊者。
2. 於5月20日後收到，註冊費不退還，但註冊者可獲得研討會論文集一冊。

## 住宿資訊:

### 蓮潭國際會館 (Garden Villa)

高雄市左營區崇德路801號

Tel: 886-7-341-3333

Fax: 886-7-343-9955

<http://www.gardenvilla.com.tw/>



## 研討會交通資訊:

### 地點: 蓮潭國際會館 (Garden Villa)

高雄市左營區崇德路801號

#### ※《開車》 (請留意停車場進入位置)

※**高速公路**: 中山高與南二高南下-接國道10號鼎金系統交流道-中華路交流道下接翠華路-左轉崇德路約距250公尺後, 會館在您右邊。

#### ※**高雄市區**:

(1) 北上: 博愛三路→左轉崇德路, 距約650公尺後, 會館在您左邊。

(2) 南下: 一號省道(民族一路)→右轉大中二路→左轉博愛三路→右轉崇德路。

#### ※《**高鐵&台鐵&捷運**》

台鐵新左營站 | 高鐵左營站 | 高捷R16高鐵左營站

往四號出口, 沿高鐵路步行穿越原生植物園, 約15分鐘。

(1) 乘301號公車, 至**蓮潭會館站** <https://goo.gl/6j1XrT>

(2) 搭捷運紅線至生態園區站, 搭乘紅51線接駁車至會館 <https://goo.gl/VbBqql>

#### ※《**搭機**》 <https://goo.gl/3o8AXg>

##### 1. 搭乘捷運:

(1) 步行崇德路往東, 至華夏路左轉直行, 至孟子路右轉直行, 至博愛三路左手邊即為捷運生態園區站(紅線)。接駁請參考前項說明。

(2) 搭乘往小港方向捷運(計12站), 至捷運小港站(紅線)。

(3) 請留意國內線/國際線出口。

2. 預約付費接送服務: 請事先洽櫃台人員。



主辦、協辦及贊助單位：



社團法人臺灣平坦化應用技術協會

中國平坦化技術聯盟

中國摩擦學會  
微納製造摩擦學專業委員會



臺灣科技大學



臺灣晶圓平坦化  
創新研究中心



臺灣財團法人金屬工業研究發展中心